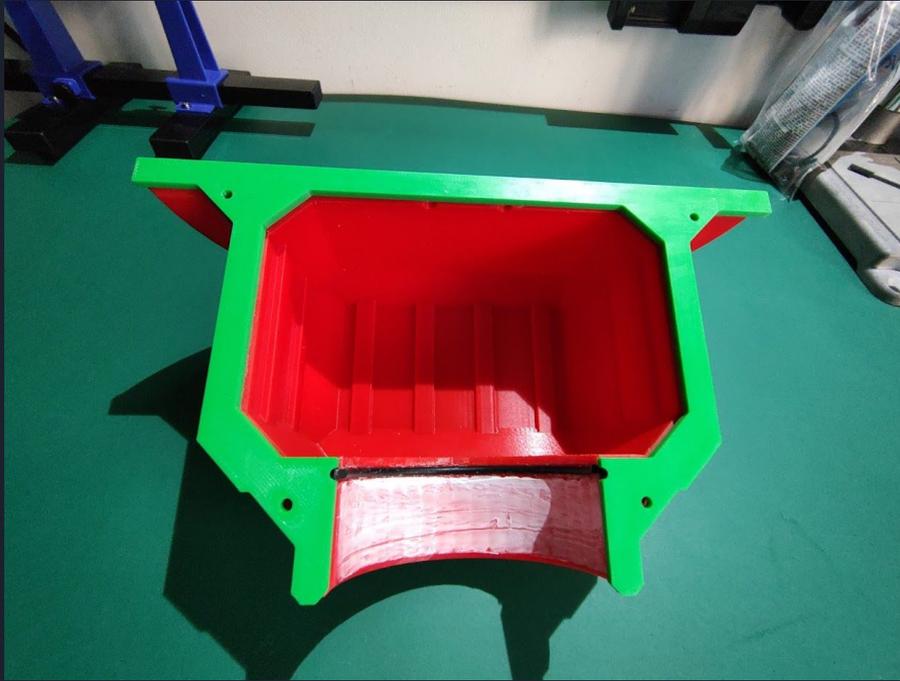


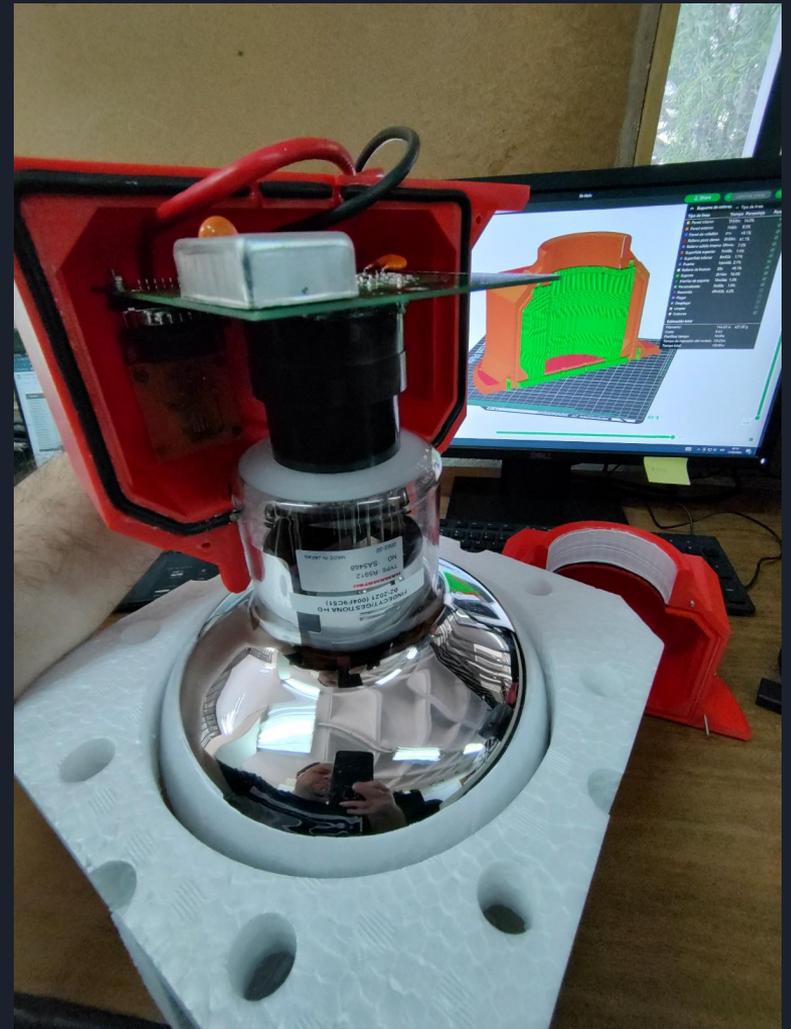


Encapsulado 3D para PMT Hamamatsu R5912

Prototipo No. 1

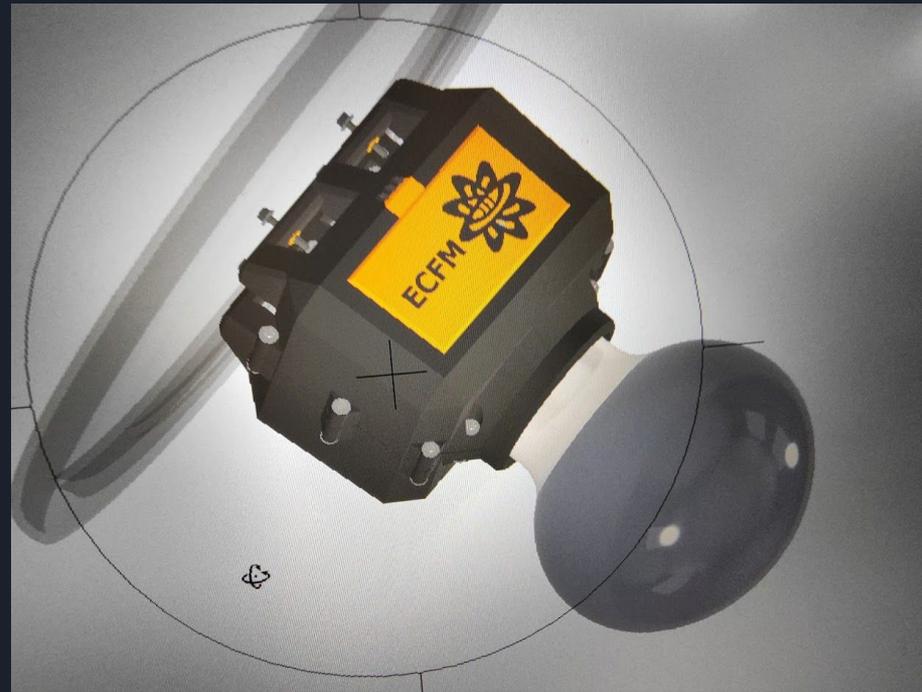
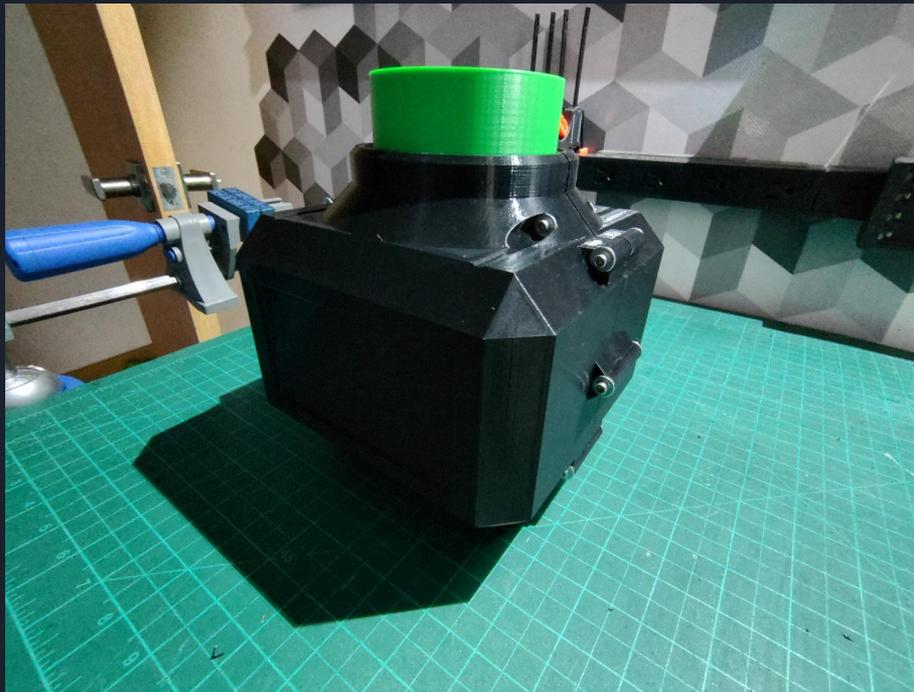


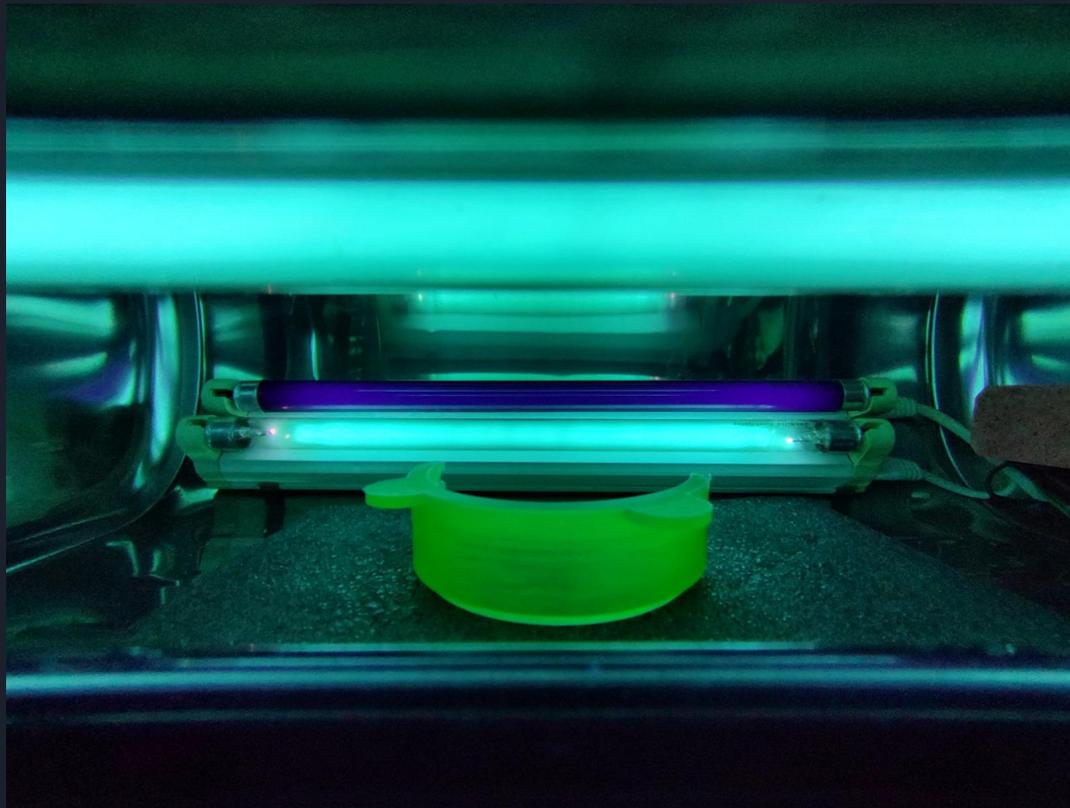
- Sello incompleto por salidas de cables
- Sello incompleto e ineficiente por empaques discontinuos y por pocos puntos de presión con tornillos.
- Sello ineficiente entre el encapsulado y el tubo (Silicon con muchas superficies irregulares).
- Inserciones roscadas muy pequeñas
- Pocas capas de impresión en pared
- Impreso en impresora FDM en material PLA



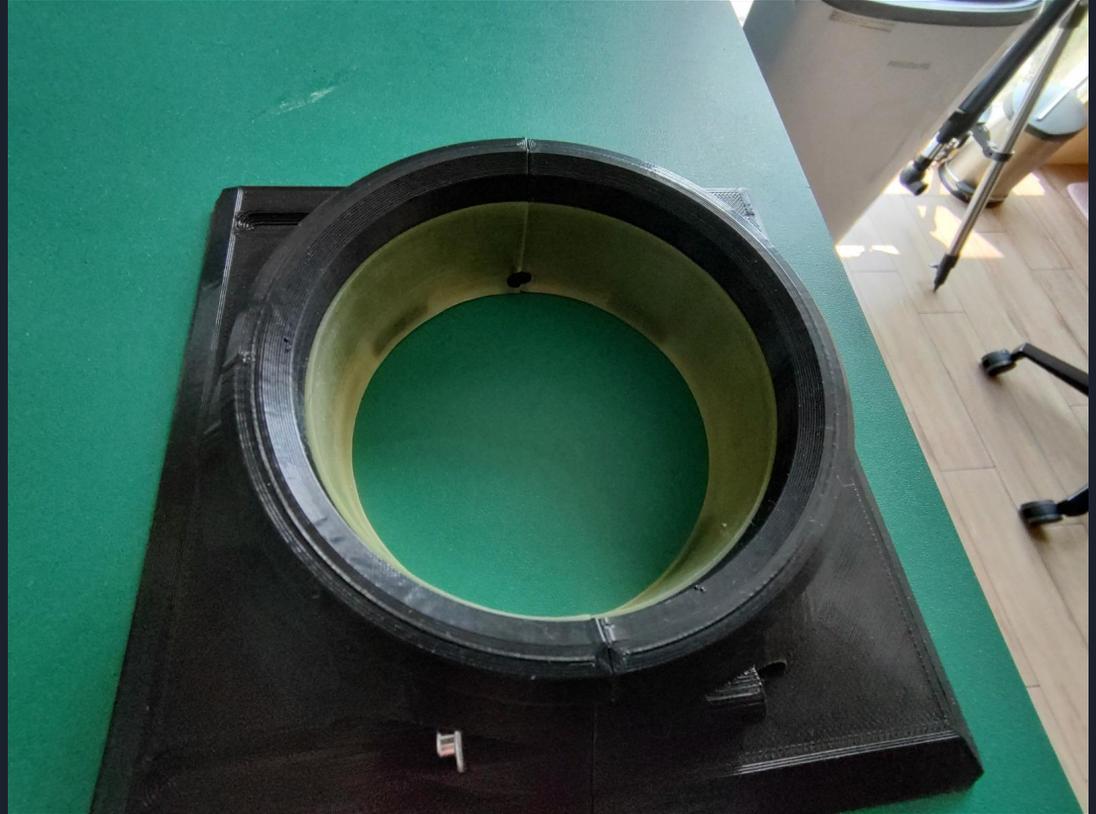


Prototipo No. 2





- Impresión LCD en resina curada con luz UV de 405 nm.
- Resina Flexible, resolución de impresión 2K (1620 x 2560 píxeles de 50um cada uno).
- Altura de capa de 10um.
- Baño de sello impermeabilizante en Aerosol al secar la resina.



- Empaque continuo
- Los cables van unidos al encapsulado plástico con silicón frío.
- Impresión en impresora FDM en material PETG.
- Impresión con 8 capas de pared, aumentando el flujo de material por el extrusor para sobreponer una capa de impresión con otra.



